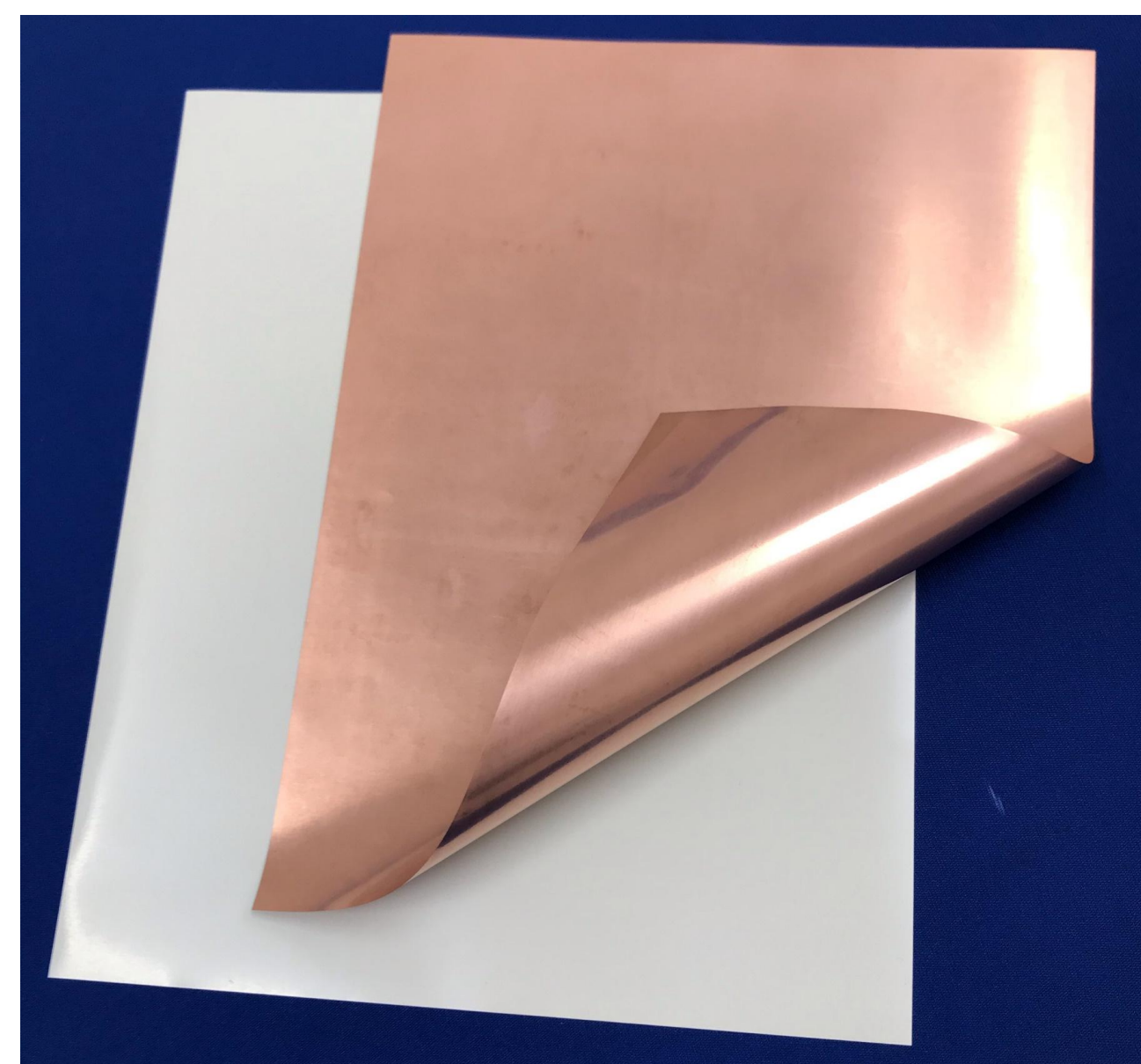


LCP基柔性覆铜板

本产品是在LCP基材上形成极薄铜层的柔性覆铜板（FCCL）。
通过SAP法可实现精细布线加工，并能形成具备优异高频特性的电路。

特征

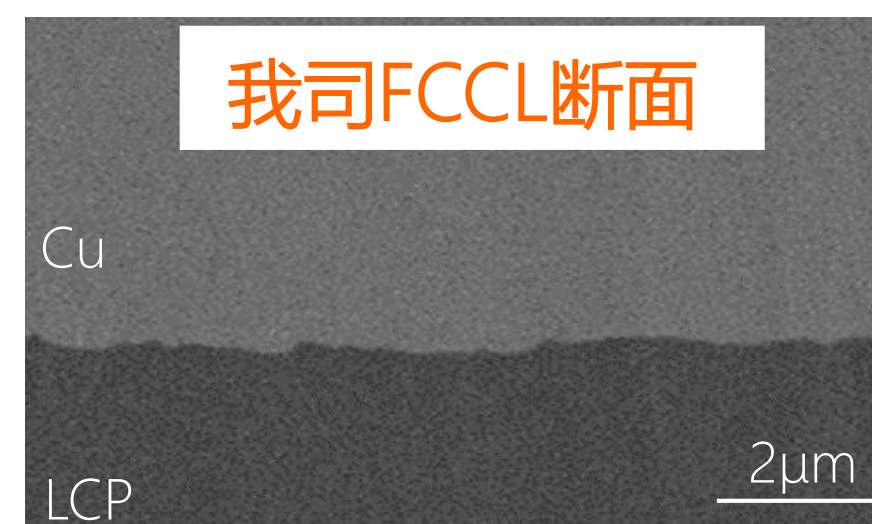


☑这是一款表面具有极薄铜层的覆铜板

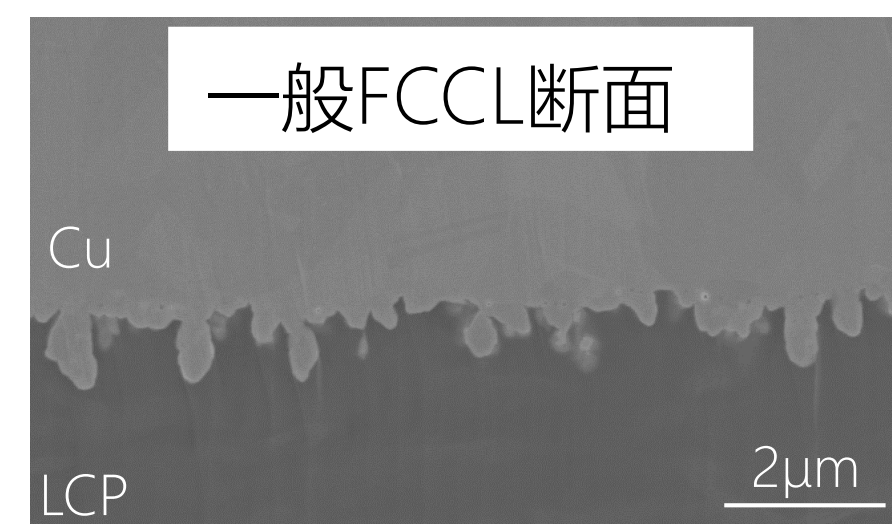
铜层厚度：0.1~0.3 μm

LCP厚度：25, 50, 100 μm

☑Cu/LCP界面在保持平滑的同时实现高密着性
无需破坏界面，即可实现铜层的高密着性



我司FCCL断面



一般FCCL断面

开发品的代表特性

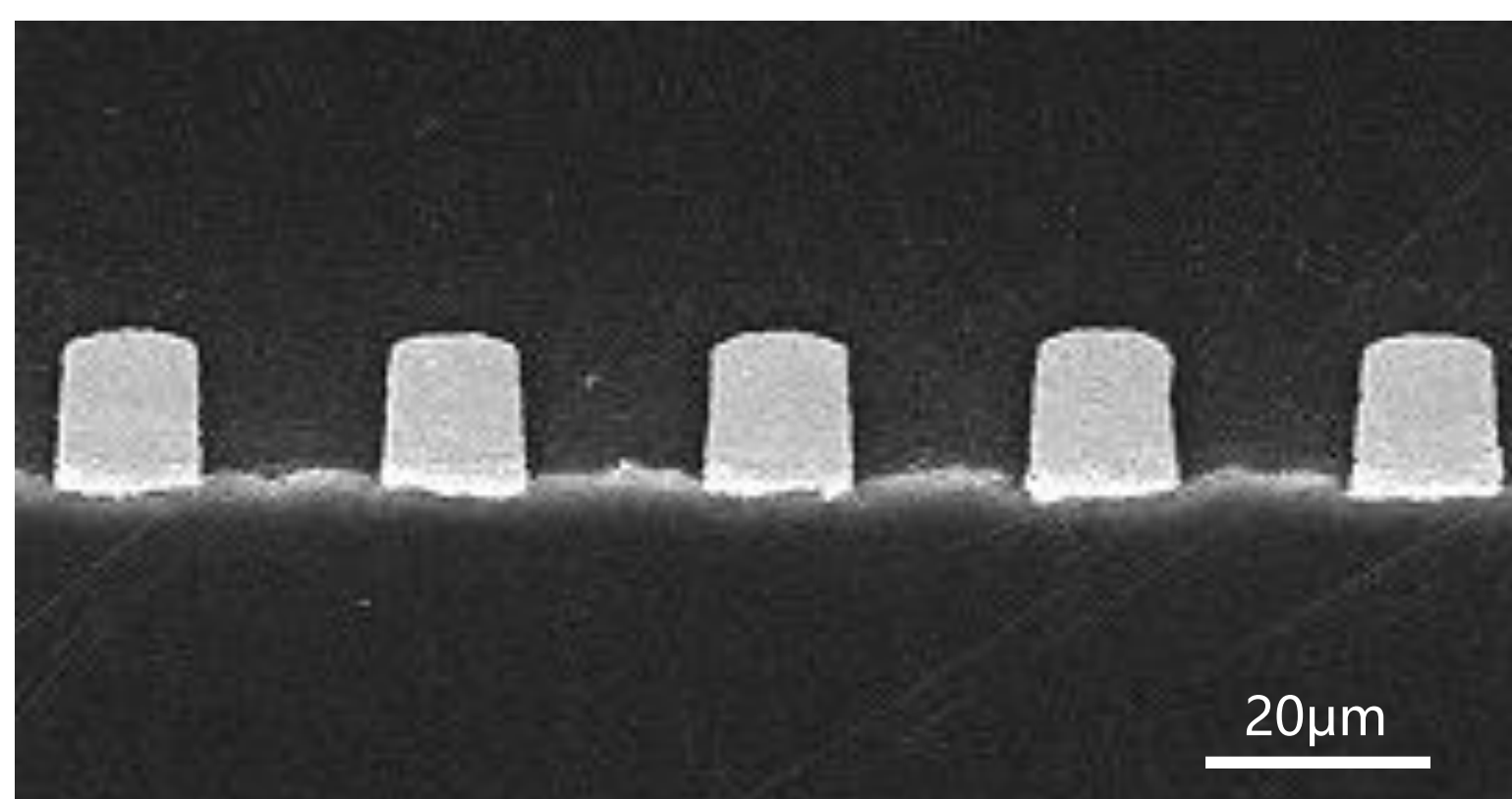
下記データは当社測定による代表値であり，保証値ではありません

項目	条件	无电解镀铜 FCCL
导体剥离强度	18 μm 镀层厚度，室温环境	0.7 N/mm
	18 μm 镀层厚度下 150℃×168小时后	0.7 N/mm
介电损耗正切	开放型谐振法	0.002
相对介电常数	法布里-珀罗法 28GHz	3.3
耐锡焊热	260℃×5秒	无异常

助力柔性电路精细化

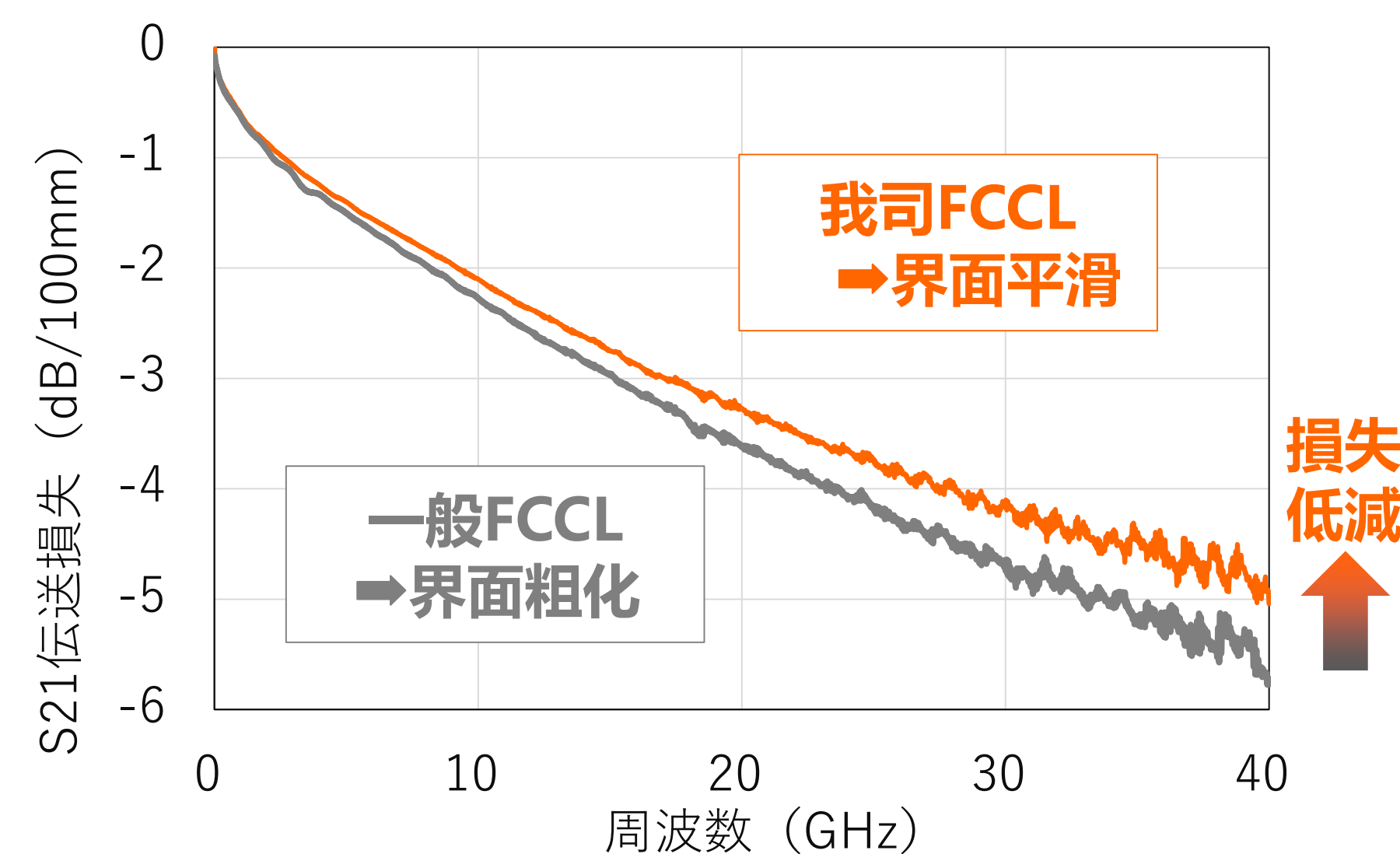
☑凭借极薄且高密着的铜层，可实现精细布线形成。

L/S=15/15 μm 布线加工示例（布线截面）



实现优异的传输特性

☑凭借界面平滑化，可降低传输损耗



为进一步提升特性的举措

☑目前正在开发LCP以外的低介电树脂基材

